

SICAS統計の2006年第1四半期（1 - 3月）の数値公表

SICAS 統計（世界半導体生産キャパシティ統計）の2006年第1四半期(1-3月)の数値がまとまったので公表いたします。生産能力の数字は断りのない限り8インチウエファー換算の数字です。なお、今回よりディスクリート・データの集計を開始しました。

2006年第1四半期(1Q)のIC合計(MOS IC+パシテ-5)の生産能力は1702.8千枚/週で前四半期(2005年4Q)の1634.7千枚/週から+4.2%増加した。前期比伸長率は2005年2Qに+1.4%、3Qに+3.3%、4Qに+3.5%と堅調に増加したが1Qもそれを継続した。1Qの前年同期比伸長率は+12.9%であった。

MOS ICの第1四半期(1Q)の生産能力は1611.0千枚/週で前四半期(2005年4Q)の1538.2千枚/週から+4.7%増加した。前年同期比伸長率は+14.8%であった。

1Qの μ (ミクロン)別の生産能力前期比伸長率は、0.7 μ 以上が+6.3%、0.4 μ 以上0.7 μ 未満が+0.2%、0.3 μ 以上0.4 μ 未満が-0.2%、0.2 μ 以上0.3 μ 未満が-4.0%、0.16 μ 以上0.2 μ 未満が-1.6%であった。SICASでは2005年1Qから0.16 μ 未満を「0.12 μ 以上0.16 μ 未満」と「0.12 μ 未満」に細分し始めたが、1Qの0.12 μ 以上0.16 μ 未満は297.8千枚/週で前期比伸長率+4.6%、0.12 μ 未満は478.1千枚/週で前期比伸長率+12.2%であった。全体としては、特に0.12 μ 未満のプラス伸長が顕著であった。

μ (ミクロン)別の1Qの稼働率は、0.7 μ 以上が85.4%(前期比-1.6ポイント)、0.4 μ 以上0.7 μ 未満が81.4%(同-7.0ポイント)、0.3 μ 以上0.4 μ 未満が80.5%(同-5.1ポイント)、0.2 μ 以上0.3 μ 未満が91.2%(同+5.9ポイント)、0.16 μ 以上0.2 μ 未満が84.0%(同-7.4ポイント)、0.12 μ 以上0.16 μ 未満が97.7%(同+0.1ポイント)、0.12 μ 未満が96.8%(同-2.1ポイント)であった。この結果MOS計では1Qの92.6%から2.4ポイント減少し、90.2%となった。

MOS計に占めるファンダリー・ウエハの生産能力(1Q)は272.0千枚/週であり、4Qに対して前期比+3.0%の伸長を示した。1Qの稼働率は91.7%であり、4Qから3.2ポイント減少した。MOS計に占める8インチウエハの生産能力は998.1千枚/週であり、4Qに比べ+1.4%増加した。SICASでは2004年1Qから12インチ(300mm)ウエハの統計を集計しているが、2006年1Qの生産能力は8インチ換算で348.5千枚/週(12インチ実枚数では154.9千枚/週)と4Qから+20.7%の伸張を示し、稼働率は96.2%(前期比-1.4%)であった。(諸データの詳細は別添をご参照ください。)

SICASは、世界の5業界団体(EECA、JEITA、KSIA、SIA、TSIA)の支援の下に、1994年に活動を開始し、現在世界の主要半導体(IC)メーカー41社が会員として参加しています。

- EECA : European Electronic Component Manufacturers Association (欧州電子部品工業会)
- JEITA : Japan Electronics & Information Technology Industries Association (電子情報技術産業協会)
- KSIA : Korea Semiconductor Industry Association (韓国半導体産業協会)
- SIA : Semiconductor Industry Association (of the US) (米国半導体工業会)
- TSIA : Taiwan Semiconductor Industry Association (台湾半導体産業協会)

SICASに参加しているICメーカーは、年4回、四半期毎に、そのIC生産能力と実投入数を地域別に委託した第三者のデータ集計機関に提出し、そこで集計された数値は最後に中央集計機関によりまとめられ、世界計の集計データとなり発表されます。

データの秘密保持のため、会員を含むいかなる関係者（データ集計機関を除く）も、公表される「世界計のデータ」以外を知り得ない仕組みとなっています。

参加会員は、各々自社の世界全体の生産能力と実投入数を連結ベースで把握し報告しますが、他のICメーカーに生産委託している部分は含みません。生産能力・実投入数のいずれもウェハ枚数を単位とし、集計期間内の総数を週当たりの平均値に換算し「千枚/週」の単位で報告します。報告方法は以下のとおりです。

今回よりディスクリット・データの集計を開始した為、参照資料の体裁が変わりました。

半導体合計=IC合計+ディスクリット計

IC合計=MOS IC+バイポーラ ICの体系となります。

*インチ換算にご注意ください。

MOS ICは、加工精度により0.7ミクロン以上、0.4ミクロン以上0.7ミクロン未満、0.3ミクロン以上0.4ミクロン未満、0.2ミクロン以上0.3ミクロン未満、0.16ミクロン以上0.2ミクロン未満、0.12ミクロン以上0.16ミクロン未満、および0.12ミクロン未満に分けて8インチウェハの枚数に換算、バイポーラ ICは加工精度の分類はなく、5インチウェハの枚数に換算。またMOS IC生産能力のうち8インチウェハと12インチウェハの生産能力および実投入数のデータも併せて集計。また生産能力については、1年=52週、1週=7日、1日=24時間の稼動を前提とします。

SICASへの参加は任意であり、いかなるICメーカー（5つの支援業界団体のどれにも属さないメーカーも含む）に対してもオープンです。四半期毎に公表されるSICAS統計は、参加会員だけでなく誰にでも入手可能であり、前述の5業界団体から入手できます。また、SICAS統計は、**全ての過去データを含め以下のWebサイトでご覧になることが出来ます。**

<http://www.sicas.info/>

SICASの運営組織は会員から選出された代表者で構成されており、現在、事務局はオランダに設置されています。

SICAS統計は、世界のIC生産能力とその稼動実績に関する信頼に足る情報をタイムリーに提供するものであり、このような情報は、IC製造設備の急速な技術革新やIC技術の各世代毎に必要な設備投資額が肥大化していることなどを考えると、半導体及び関連産業にとって有用な参考情報であると考えられます。

なお、日本地域の運営組織として、SICAS Japanが1995年1月に設立されました。

お問い合わせ先：SICAS Japan 委員会

委員長 齊藤 律三 [(株) 東芝]

TEL: 03-3457-3376

FAX: 03-5444-9342